证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-047

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、已审议通过的综合授信额度

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月20日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属公司(包括纳入公司合并报表范围的各级子公司)向银行等金融机构申请合计总额不超过等值人民币6亿元(含6亿元,实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、林吉特等)的综合授信额度(最终以实际审批的授信额度为准)。上述额度在授权期限内可以循环使用,公司及下属公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会。具体内容详见公司于2026年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-008)。

二、本次增加综合授信额度的情况

为更好地满足公司发展规划和战略实施的需要,公司及下属公司(包括纳入公司合并报表范围的各级子公司)拟在上述已审议通过的综合授信额度的基础上,增加不超过等值人民币8亿元(含8亿元,实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、林吉特等)的综合授信额度(最终以实际审批的授信额度为准)。本次增加后,公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度合计总额不超过等值人民币14亿元(含本次新增额度,实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、林吉特等)。

上述额度在授权期限内可以循环使用,公司及下属公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会。董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、固定资产项目贷款等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。授权期限自本次董事会审议通过之日起至2027年1月19日止。

公司及下属公司可以不动产、动产或权益向银行、担保公司等金融机构为公司上述申请银行综合授信额度等相关事项提供担保,具体担保、反担保的金额、方式以公司与银行、担保公司等金融机构最终协商签订的担保协议为准。

三、审议程序

本次增加向金融机构申请综合授信额度事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会第二十九次会议审议通过。本事项无需提交公司股东会审议。

四、对公司的影响

本次增加向金融机构申请综合授信额度事项,是为了更好地满足公司发展规划和战略实施的需要,不会对公司及下属公司的生产经营和业务发展造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026年6月24日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-045

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2026年6月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月17日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事6人)。

会议由董事长崔学峰召集并主持,部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

根据2026年1-5月实际发生的关联交易金额,结合公司经营需要,公司拟将2026年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司的关联交易预计总额度从1.6亿元增加至3亿元(增加预计总额度1.4亿元)。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(其中关联董事吴华先生回避表决)。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-046)。

本议案审议通过后,尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

为更好地满足公司发展规划和战略实施的需要,公司及下属公司(包括纳入公司合并报表范围的各级子公司)拟在此已审议通过的综合授信额度的基础上,增加不超过等值人民币8亿元(含8亿元,实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、林吉特等)的综合授信额度(最终以实际审批的授信额度为准)。本次增加后,公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度合计总额不超过等值人民币14亿元(含本次新增额度,实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、林吉特等)。

上述额度在授权期限内可以循环使用,公司及下属公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会。董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、固定资产项目贷款等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。授权期限自本次董事会审议通过之日起至2027年1月19日止。

公司及下属公司可以不动产、动产或权益向银行、担保公司等金融机构为公司上述申请银行综合授信额度等相关事项提供担保,具体担保、反担保的金额、方式以公司与银行、担保公司等金融机构最终协商签订的担保协议为准。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-047)。

(三)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年7月9日召开公司2026年第三次临时股东会,审议如下议案:

序号	审议事项
1	《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-048)。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026年6月24日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-046

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次关联交易事项尚需提交股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需,有利于公司业务的发展,且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形,公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年6月22日,天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司独立董事专门会议审议后认为:本次关联交易预计符合公司业务的发展需要,交易价格公允,对公司经营活动及财务状况不存在不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,一致同意将以上议案提交董事会审议,关联董事应当回避表决。

公司审计委员会审议后认为:本次日常关联交易事项涉及的交易价格遵循市场化原则,没有损害公司和股东权益的情形,符合法律、法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定,一致同意将以上议案提交董事会审议,关联董事应当回避表决。

2026年6月23日,公司第二届董事会第二十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东会审议,关联董事吴华回避表决。

公司董事会审议后认为:本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况,为公司正常经营所需,有利于公司业务的发展,且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形,公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次增加2026年度日常关联交易预计额度超过本公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易事项需提交公司股东会审议,关联股东南通华泓投资有限公司将回避表决。

(二)本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据2026年1-5月实际发生的关联交易金额,结合公司经营需要,公司拟将2026年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司的关联交易预计总额度从1.6亿元增加至3亿元(增加预计总额度1.4亿元),具体内容如下:

关联交易类别	关联方名称	2026年原预计额度(万元)	2026年内部调剂后的预计额度(万元)注2	本次拟增加预计额度(万元)	本次增加后2026年预计总额度(万元)	2025年内部调剂后的预计额度(万元)注2	2025年实际发生金额(经审计)(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	通富微电子股份有限公司	1,000	2,700	增加1,000	3,700	3,700	3,213.76	/
向关联方销售商品	苏州通富超威半导体有限公司	500	100		100	100	75.61	/
向关联方销售商品	南通通富微电子有限公司	3,000	1,000		1,000	1,000	684.58	/
向关联方销售商品	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.	2,100	1,200		1,200	1,200	862.56	/
向关联方销售商品	合肥通富微电子有限公司	500	500		500	600	559.67	/
向关联方销售商品	通富通科(南通)微电子有限公司	1,000	2,600	增加500	3,100	3,000	2,529.15	/
向关联方租赁房产	上海新阶实业股份有限公司	1,440	1,440		1,440	1,440	1,045.61	/
小计		9,540	9,340	增加1,500	11,040	11,040	8,970.94	/

注1:上述关联交易在关联交易预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂,苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司,前述6家公司为同一控制下的不同关联方,关联交易金额可以内部调剂;

注2:本列为公司根据实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要,在关联交易预计总额范围内,对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额;

注3:上表中,2026年1-5月实际发生金额均为含税金额;

注4:2024年12月,公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2025-2027年度将继续向上海新阴实业股份有限公司租赁房产,每个年度发生不超过1,440万元的日常关联交易。

(三)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年12月,公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,预计2025年度将与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司等发生总额不超过8,100万元的日常关联交易;同时,公司2025-2027年度将继续向上海新阴实业股份有限公司租赁房产,预计与上海新阴实业股份有限公司每个年度发生总额不超过1,440万元的日常关联交易。

2025年12月,公司第二届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易的议案》,同意将2025年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司的关联交易预计总额度从8,100万元增加至9,600万元(增加预计总额度1,500万元),相关日常关联交易预计和执行情况详见下表:

关联交易类别	关联方名称	2025年原预计额度(万元)	2025年内部调剂后的预计额度(万元)注2	增加预计额度(万元)	增加后2025年预计额度(万元)	2025年内部调剂后的预计额度(万元)注2	2025年实际发生金额(经审计)(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	通富微电子股份有限公司	1,000	2,700	增加1,000	3,700	3,700	3,213.76	/
向关联方销售商品	苏州通富超威半导体有限公司	500	100		100	100	75.61	/
向关联方销售商品	南通通富微电子有限公司	3,000	1,000		1,000	1,000	684.58	/
向关联方销售商品	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.	2,100	1,200		1,200	1,200	862.56	/
向关联方销售商品	合肥通富微电子有限公司	500	500		500	600	559.67	/
向关联方销售商品	通富通科(南通)微电子有限公司	1,000	2,600	增加500	3,100	3,000	2,529.15	/
向关联方租赁房产	上海新阴实业股份有限公司	1,440	1,440		1,440	1,440	1,045.61	/
小计		9,540	9,340	增加1,500	11,040	11,040	8,970.94	/

注1:上述关联交易在关联交易预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂,苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司,前述6家公司为同一控制下的不同关联方,关联交易金额可以内部调剂;

注2:本列为公司根据实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要,在关联交易预计总额范围内,对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额;

注3:上表中,2026年1-5月实际发生金额均为含税金额;

注4:2024年12月,公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2025-2027年度将继续向上海新阴实业股份有限公司租赁房产,每个年度发生不超过1,440万元的日常关联交易。

(三)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年12月,公司第二届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易的议案》,同意将2025年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司等发生总额不超过8,100万元的日常关联交易;同时,公司2025-2027年度将继续向上海新阴实业股份有限公司租赁房产,预计与上海新阴实业股份有限公司每个年度发生总额不超过1,440万元的日常关联交易。

2025年12月,公司第二届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易的议案》,同意将2025年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司的关联交易预计总额度从1.6亿元增加至3亿元(增加预计总额度1.4亿元),具体内容如下:

关联交易类别	关联方名称	2026年原预计额度(万元)	2026年内部调剂后的预计额度(万元)注2	本次拟增加预计额度(万元)	本次增加后2026年预计总额度(万元)	2025年内部调剂后的预计额度(万元)注2	2025年实际发生金额(经审计)(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	通富微电子股份有限公司	1,000	2,700	增加1,000	3,700	3,700	3,213.76	/
向关联方销售商品	苏州通富超威半导体有限公司	500	100		100	100	75.61	/
向关联方销售商品	南通通富微电子有限公司	3,000	1,000		1,000	1,000	684.58	/
向关联方销售商品	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.	2,100	1,200		1,200	1,200	862.56	/
向关联方销售商品	合肥通富微电子有限公司	500	500		500	600	559.67	/
向关联方销售商品	通富通科(南通)微电子有限公司	1,000	2,600	增加500	3,100	3,000	2,529.15	/
向关联方租赁房产	上海新阴实业股份有限公司	1,440	1,440		1,440	1,440	1,045.61	/
小计		9,540	9,540	增加1,500	11,040	11,040	8,970.94	/

注1:上述关联交易在关联交易预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂,苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司,前述6家公司为同一控制下的不同关联方,关联交易金额可以内部调剂;

注2:本列为公司根据实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要,在关联交易预计总额范围内,对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额;

注3:上表中,2026年1-5月实际发生金额均为含税金额;

注4:2024年12月,公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2025-2027年度将继续向上海新阴实业股份有限公司租赁房产,每个年度发生不超过1,440万元的日常关联交易。

二、关联人基本情况和关联关系

1.通富微电子股份有限公司

(1)关联人的基本情况

公司名称	通富微电子股份有限公司
统一社会信用代码	91320000608319740X
公司类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	石磊
注册资本	151,759.6912万元
成立日期	1994年2月4日
住所及主要办公地点	南通市崇川路288号
主营业务	研发、生产、销售集成电路等半导体产品,提供相关的技术服务;自营和代理上述商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联人2025年度主要财务数据如下:

项目	2025年12月31日(经审计)
总资产	472.66亿元
净资产	164.94亿元
项目	2025年度(经审计)
营业收入	279.21亿元
净利润	12.19亿元

(2)与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的其他公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,通富微电子股份有限公司为公司关联方。

(3)履约能力分析:通富微电子股份有限公司为依法存续且经营正常的深交所主板上市公司,财务及资信状况良好,经营稳健,前次关联交易执行情况良好,具有良好的履约能力。

2.苏州通富超威半导体有限公司

(1)关联人的基本情况

公司名称	苏州通富超威半导体有限公司
统一社会信用代码	91320500675866188L
公司类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	石磊
注册资本	13,338万美元
成立日期	2004年3月26日
住所及主要办公地点	苏州工业园区苏桐路88号
主营业务	研发、生产、销售集成电路、半导体产品,提供相关的技术服务和维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联人2025年度主要财务数据如下:

项目	2025年12月31日(经审计)
总资产	73.58亿元
净资产	8.59亿元
项目	2025年度(经审计)
营业收入	26.75亿元
净利润	-3.74亿元

(2)与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司,南通通富微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,南通通富微电子有限公司为公司关联方。

(3)履约能力分析:南通通富微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,前次关联交易执行情况良好,具有良好的履约能力。

4.TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.

(1)关联人的基本情况

公司名称	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.
公司类型	有限责任公司
法定代表人	石磊
注册资本	54,849,473万马来西亚林吉特
成立日期	1978年8月3日
住所及主要办公地点	Suite A, Level 9, Wawasan Open University, 54, Jalan Sultan Ahmad Shah, Penang 10050 Malaysia
主营业务	从事半导体封装和测试业务

关联人2025年度主要财务数据如下:

项目	2025年12月31日(经审计)
总资产	96.11亿元
净资产	33.36亿元
项目	2025年度(经审计)
营业收入	94.11亿元
净利润	4.59亿元

(2)与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司,TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.为通富微电子股份有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.为公司关联方。

(3)履约能力分析:TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,前次关联交易执行情况良好,具有良好的履约能力。

5.合肥通富微电子有限公司

(1)关联人的基本情况

公司名称	合肥通富微电子有限公司
统一社会信用代码	91340100229039003A
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	石磊
注册资本	250,000万元
成立日期	2015年1月23日
住所及主要办公地点	安徽省合肥市经济技术开发区卫星路678号
主营业务	集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联人2025年度主要财务数据如下:

项目	2025年12月31日(经审计)
总资产	22.93亿元
净资产	6.72亿元
项目	2025年度(经审计)
营业收入	12.17亿元
净利润	0.01亿元

(2)与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司,合肥通富微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,合肥通富微电子有限公司为公司关联方。

(3)履约能力分析:合肥通富微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,前次关联交易执行情况良好,具有良好的履约能力。

6.通富通科(南通)微电子有限公司

(1)关联人的基本情况

公司名称	通富通科(南通)微电子有限公司
统一社会信用代码	91320600MA27W9WW2L
公司类型	有限责任公司
法定代表人	石磊
注册资本	80,000万元
成立日期	2021年10月22日
住所及主要办公地点	南通市通京大道236号11幢
主营业务	一般项目:集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联人2025年度主要财务数据如下:

项目	2025年12月31日(经审计)
总资产	40.42亿元
净资产	3.49亿元
项目	2025年度(经审计)
营业收入	15.98亿元
净利润	-0.80亿元

(2)与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司,通富通科(南通)微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,通富通科(南通)微电子有限公司为公司关联方。

(3)履约能力分析:通富通科(南通)微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,前次关联交易执行情况良好,具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

通富微电子股份有限公司及其控股子公司是公司的重要客户,公司主要为其供应半导体测试分选机及相关备品备件。产品价格遵循市场化原则,由协议双方根据市场情况协商确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需,有利于公司业务的发展,且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允。本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项没有损害公司和股东权益的情形,公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026年6月24日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-048

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年7月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年7月9日14点30分

召开地点:上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月9日

至2026年7月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,相关公告已于2026年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:南通华泓投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别相同品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603061	金海通	2026/7/2

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2026年7月6日(上午9:00-11:30;下午13:00-17:00)。

(二)登记地点

上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部。

(三)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件1)。

3、融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书(格式见附件1)办理登记。投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(格式见附件1)。

4、股东或其委托代理人可于登记截止时间之前以专人送达、信函、传真或电子邮件方式办理登记(须在2026年7月6日17:00之前送达公司或发送邮件至联系邮箱)。以通讯方式进行登记的股东,请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

5、公司本次股东会不接受电话方式登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联系方式

联系地址:上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部

电话:021-52277906

邮箱:jhtdesign@jht-design.com

联系人:刘海龙、蔡亚茹

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026年6月24日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津金海通半导体设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月9日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2026-053

上海吉祥航空股份有限公司 关于股份回购比例达2%及回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/12/25
回购方案实施期限	2026年3月24日-2026年6月23日
预计回购金额	25,000万元-50,000万元
回购价格上限	14.31元/股
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	43,869,704股
实际回购股数占总股本比例	2.01%
实际回购金额	499,917,060.74元
实际回购价格区间	10.47元/股-12.36元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2026年3月24日,上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购股份全部用于维护公司价值及股东权益(出售)。回购资金总额不低于人民币25,000万元(含),不超过人民币50,000万元(含),回购价格不超过人民币14.50元/股(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。详见公司于2026年3月25日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-014)。

公司于2026年6月5日披露了《上海吉祥航空股份有限公司关于实施2025年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:临2026-047),根据有关规定和《上海吉祥航空股份有限公司关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》,自2026年6月11日起,公司回购股份价格上限由不超过人民币14.50元/股(含)调整为不超过人民币14.31元/股(含)。除调整股份回购价格上限外,本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化,具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。

二、回购实施情况

(1)2026年3月25日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了